

П А С П О Р Т

3.402.019 ПСИ

Микросхема типа К217ЛБ1А, К217ЛБ1Б соответствует техническим условиям
6К0.348.011 ТУ

1. Функциональное назначение — логическая схема „И-НЕ/ИЛИ-НЕ“.
2. Режим работы:
 - напряжение питания:
 - $E_1 - В$ $6,0 \pm 10\%$
 - $E_2 - В$ $3,0 \pm 10\%$
 - потребляемая мощность от источника питания:
 - $E_1 - мВт$ 13
 - $E_2 - мВт$ 7,3
3. Основные электрические параметры при $T = +25 \pm 10^\circ C$
 - $I_{вх}$ — входной ток, мА $1,7 - 2,1$
 - $I_{з. вых}$ — выходной ток закрытой микросхемы, мкА не более 1,0
 - $U_{в}$ — верхний уровень выходного напряжения, В не менее 2,6
 - $U_{н}$ — нижний уровень выходного напряжения, В не более 0,3
 - t_3^{10} — время задержки распространения на включение, нс, не более 12
 - t_3^{01} — время задержки распространения на выключение, нс, не более 35
 - нагрузочная способность:
 - К217ЛБ1А — 4 микросхемы К217 ЛБ1А или К217ЛБ1Б
 - К217ЛБ1Б — 6 микросхем К217 ЛБ1А или К217ЛБ1Б
 - коэффициент объединения по коллектору, не более 8
 - количество входов по схеме „И“ 8
4. Указание содержания драгоценных металлов: см. штамп „Содержит драгметаллы“.
5. Указания и рекомендации по установке, монтажу и эксплуатации:
- а) Рекомендации по лужению методом погружения в расплавленный припой:
 - температура расплавленного припоя, $^\circ C$ не более 250
 - время погружения, с, не более 2
 - расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода), мм, не менее 1
 - допустимое количество погружений, не более 2
 - интервал между двумя погружениями, мин. не менее 5
 - припой и флюсы — по нормали НО.054.063.
- б) Рекомендации по установке:
 - Установку микросхем на плату производят с зазором $1^{+0,5}$ мм. Крепление микросхем к печатной плате в аппаратуре может быть произведено методом припайки к выводам без какого-либо механического крепления.
- в) Рекомендации по пайке микросхем одножальным паяльником:
 - температура жала паяльника, $^\circ C$, не более 280
 - время касания каждого вывода, с, не более 3
 - расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода), мм не менее 1
 - интервал между двумя пайками соседних выводов, с, не менее 10
 - Жало паяльника должно быть заземлено.
- г) Рекомендации по групповой пайке:
 - температура расплавленного припоя $^\circ C$ не более 265
 - время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы), с, не более 3
 - расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода), мм, не менее 1
 - интервал между двумя повторными пайками выводов, мин, не менее 5

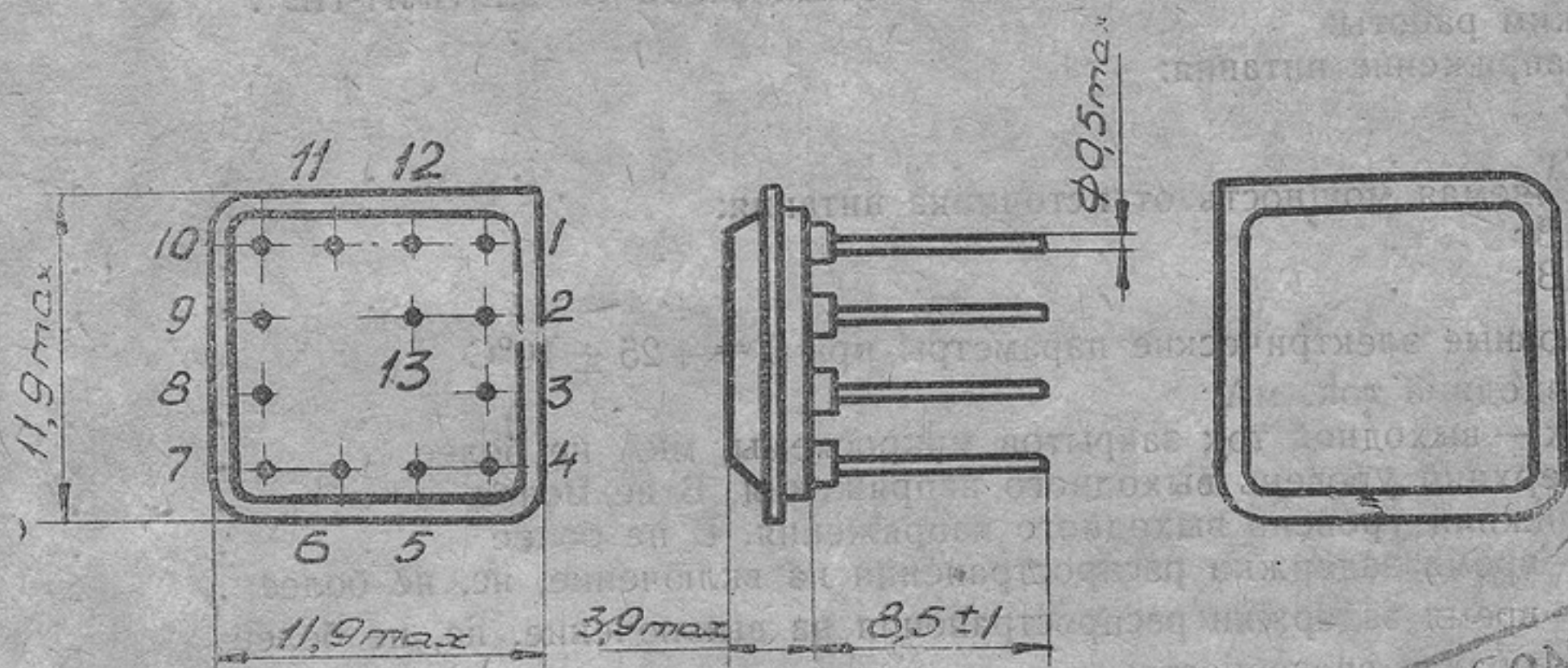
Примечание: При пайке или сварке выводов следует применять меры, исключающие тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.
- д) Рекомендации по очистке от флюса, влагозащите:
 - рекомендуется применять для очистки от флюса жидкости в соответствии с нормалью НО.054.063;
 - рекомендуется для влагозащиты применять лак УР-231, МРТУ-6-10-863-69, или Э-4100, МРТУ 6-10-857-69.
 - Примечание. Для очистки от флюса и влагозащиты микросхем допускается применять любые другие моющие жидкости и лаки, не оказывающие вредного химического воздействия на покрытие, маркировку и материал корпуса, после согласования со специализированной организацией по применению интегральных микросхем и проведения соответствующих испытаний.
6. Условия эксплуатации
 - температура окружающей среды от $-45^\circ C$ до $+70^\circ C$;
 - относительная влажность воздуха 98% при температуре $T = +25^\circ C$;
 - вибрация с ускорением до $10g$ в диапазоне частот от 1 до 600 Гц;
 - многократные удары с ускорением до $75g$;
 - линейные (центробежные) ускорения до $25g$.

7. Время наработки — 10000 час.
8. Срок хранения — 6 лет.
9. Гарантии предприятия-изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждой поставляемой микросхемы всем требованиям ГОСТ 18725—73 и ТУ в течение срока сохраняемости или наработки при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а также указаний по применению, монтажу и эксплуатации установленных ГОСТ 18725—73 и ТУ.

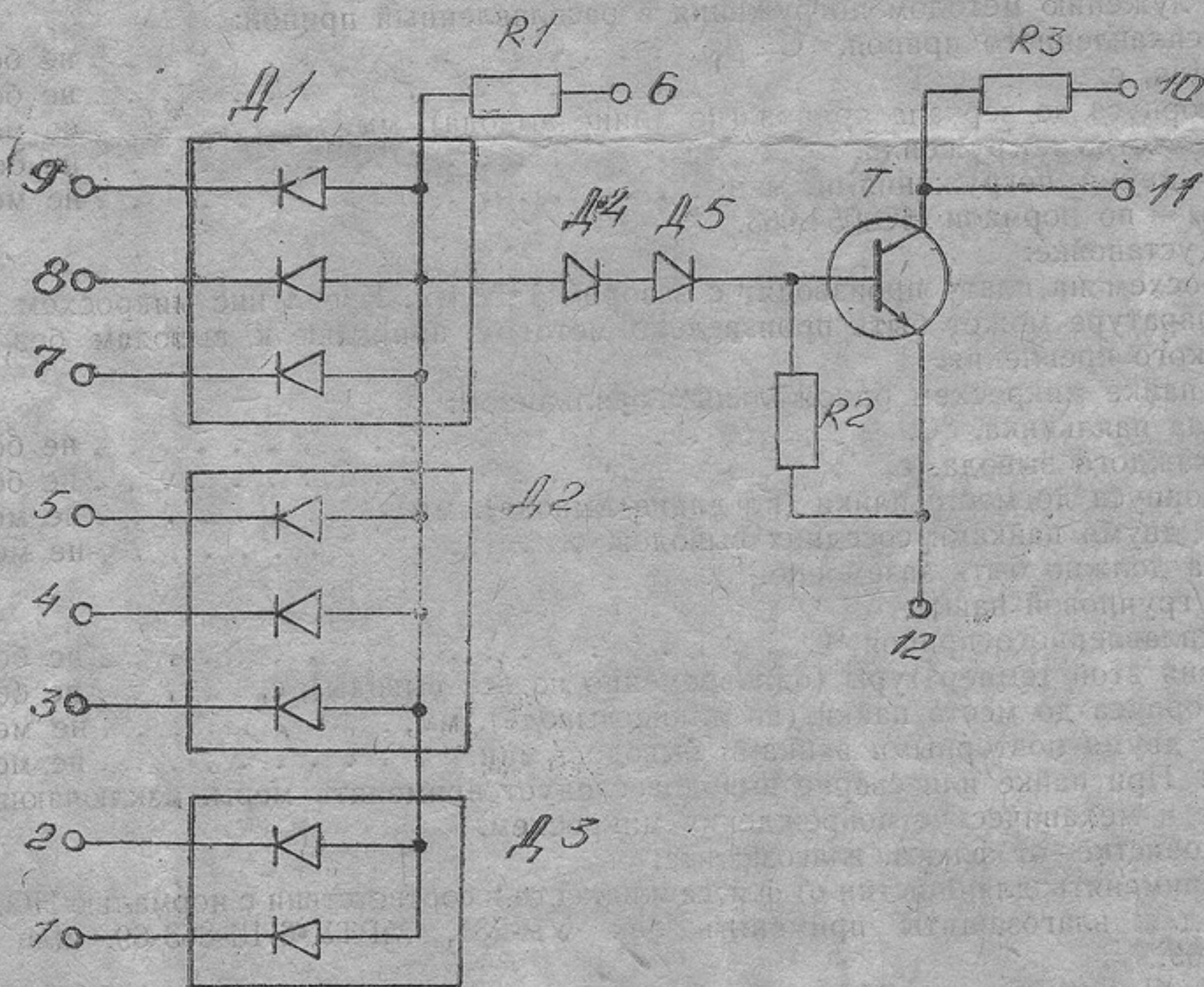
Срок гарантии исчисляется со дня отгрузки микросхем потребителю.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Масса микросхемы не более 1,5 г.

Схема электрическая принципиальная
микросхем 217ЛБ1А, 217ЛБ1Б



$R1 = 3,0 \text{ кОм} \pm 5\%$

$R2 = 7,0 \text{ кОм} \pm 20\%$

$R3 = 1,5 \text{ кОм} \pm 10\%$

Вариант I Д—3 Диодная матрица 2Д910Б или 2Д910В

Вариант I Д1, Д2—Диодная матрица 2Д910В

Вариант I Д4, Д5—Диодная матрица 2Д910 А

Вариант I ПП—Транзистор кремниевый 2Т318Б или 2Т318В

Вариант II Д1, Д3—Диодная матрица 2Д912А

Вариант II Д4, Д5—Диодная матрица 2Д912Б

Вариант II ПП—Транзистор кремниевый 2Т333Б или 2Т333В

Вариант II обозначается треугольником цвета маркировки

Дата выпуска _____

Штамп ОТК